



平成 20 年 10 月 9 日

各 位

会 社 名 T O W A 株式会社
コード番号 6315 (東証・大証 1 部)
問 合 せ 先 取締役専務執行役員経営企画室長
西村 永和
TEL (075) 692 - 0251

九州事業所第 2 工場建設のお知らせ

当社は、生産能力増強を図るため佐賀県鳥栖市にあります九州事業所に「第 2 工場」を建設することとしましたので、お知らせいたします。

記

1．建設の目的

当社は、半導体製造の後工程で使用される半導体樹脂封止装置の世界トップシェアを誇っております。特に半導体樹脂封止装置に搭載される超精密金型は当社のコア・コンピタンスであり、世界中の半導体メーカーから高い評価を得ております。

当社は半導体メーカーからの超精密金型の需要および納期短縮要求にお応えするために生産能力増強を図ってまいりましたが、工場スペースが手狭となり、このたび九州事業所に第 2 工場を建設することにいたしました。これにより、九州事業所における金型の生産能力を現状の月産 38 型から 78 型に拡大することが可能となります。

また、この工場内にて、一括で樹脂封止した半導体を個片状に切断するシンギュレーション装置の組み立ておよび調整をスタートさせる予定であります。

2．九州事業所の概要

事業所名：T O W A 株式会社 九州事業所

所在地：佐賀県鳥栖市弥生が丘七丁目 27 番地 (鳥栖北部丘陵新都市内)

主な業務：超精密金型・半導体製造装置の製造

敷地面積：10,938.96 m² (増減なし)

延床面積：既存 2,619.54 m²

新規 3,937.42 m² (第 2 工場部分)

合計 6,556.96 m²

投資総額：23 億円 (建物・機械装置等含む)

竣 工：平成 21 年 9 月 (予定)

生 産 高：平成 21 年 3 月期見込 23 億円

平成 24 年 3 月期目標 89 億円

従業員数：平成 20 年 9 月末現在 55 名 (パート等を含む)

平成 24 年 3 月期計画 140 名 (パート等を含む)

3．鳥栖市との締結式

本日 11 時から佐賀県鳥栖市役所において、橋本康志鳥栖市長および当社社長河原洋逸による立地に関する協定書の締結式および記者会見を行う予定であります。

以 上